



导热界面材料技术说明书

导热泥/Thermal Paste

TDS No.: DB-TDS-283

Rev. A

产品名称:TB-100

TB-100 是一种柔软的环氧树脂基导热绝缘粘接复合材料。TB-100 表面具有弱粘性, 可将功率晶体管暂时固定在散热器表面, 在加热固化过程中, 晶体管和散热器之间施加一定的压力, 当 TB-100 固化过程中熔融变形, 充分润湿晶体管和散热器表面, 增加附着力。固化后, 器件被固定粘接。

TB-100 技术参数

产品性能	测试结果	测试方法
组份构成	陶瓷颗粒填充环氧绝缘膜	-
颜色	浅褐色	目测
密度	2.4512 g/cc	氦气真密度法
Lap Shear Strength	>300Psi	ASTM D3163 (Modified)
厚度	0.15mm	-
使用温度范围	0°C to 180°C	-
固化条件	150°C 15min	
抗扭矩*	>2 N.m	ASTM D2063
保存期限(8-30°C)	室温 60days	-
热性能		
导热系数	0.8W/mK	Hot Disk
热阻 @ 50psi	0.3°C-in ² /W	ASTM D5470
电性能		
介电击穿强度	6 kV	ASTM D149
体积电阻	5.5x10 ¹⁵ ohm-cm	ASTM D257
介电常数 @ 1MHz	3.8	ASTM D150

*T0-220 (10psi for 10 seconds Post-Cured)

说明

本文的数据是实验室条件下获得, 由于使用条件的差异, 使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。德邦公司不担保销售德邦产品和特定工况下使用德邦产品出现的问题, 不承担任何直接, 间接或意外损失责任。

用户在使用过程遇到什么问题, 可以和德邦公司技术服务部联系, 我们将为您提供一切帮助。

深圳德邦界面材料有限公司

深圳龙岗区高桥产业园飞莱特工业厂区

电话: 0755-28396970

传真: 0755-28396971

邮编: 518117

http://www.darbond.com